

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003979

International filing date: 08 March 2005 (08.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-076942
Filing date: 17 March 2004 (17.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

10.3.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 3月17日
Date of Application:

出願番号 特願2004-076942
Application Number:

パリ条約による外国への出願に用いる優先権の主張の基礎となる出願の国コードと出願番号
The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

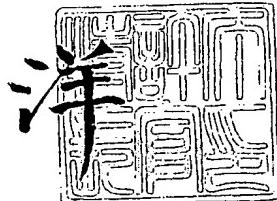
JP 2004-076942

出願人 浜松ホトニクス株式会社
Applicant(s):

2005年 4月20日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



出証番号 出証特2005-3036159

【書類名】 特許願
【整理番号】 2004-0032
【提出日】 平成16年 3月17日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01S 5/024
【発明者】
【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社
内
【氏名】 宮島 博文
【発明者】
【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社
内
【氏名】 菅 博文
【特許出願人】
【識別番号】 000236436
【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社
【代理人】
【識別番号】 100088155
【弁理士】
【氏名又は名称】 長谷川 芳樹
【選任した代理人】
【識別番号】 100092657
【弁理士】
【氏名又は名称】 寺崎 史朗
【選任した代理人】
【識別番号】 100124291
【弁理士】
【氏名又は名称】 石田 悟
【選任した代理人】
【識別番号】 100107456
【弁理士】
【氏名又は名称】 池田 成人
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 014708
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

半導体レーザアレイと、該半導体レーザアレイに取り付けられたヒートシンクと、該ヒートシンク内を流通する冷媒と、該冷媒を前記ヒートシンクに供給する冷媒供給手段と、前記ヒートシンクと前記冷媒供給手段との間に接続され、前記冷媒が流通する絶縁性配管とを備え、

前記冷媒は、フルオロカーボンを含み、

前記絶縁性配管は、内部に導電体が配置され、

前記導電体は、接地されていることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項2】

前記導電体は、前記絶縁性配管内の流路断面を覆うメッシュ構造を有するものであることを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ装置。

【請求項3】

前記導電体は、前記冷媒の流線に平行な断面が流線形の部分を含んでいることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の半導体レーザ装置。

【請求項4】

前記絶縁性配管は局所的に内径が拡大した拡径部を含み、該拡径部に前記導電体が配置されていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の半導体レーザ装置。

【請求項5】

平板状の前記半導体レーザアレイと平板状の前記ヒートシンクとが、交互に複数積層されていることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の半導体レーザ装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体レーザ装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体レーザ装置に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、数W～100Wという高い出力を有する半導体レーザ装置が開発されている。このような半導体レーザ装置は、レーザメス、レーザハンドゴテ、レーザマーカーの光源としても使用されている。

【0003】

半導体レーザアレイの電気-光変換効率は、50%程度であるため、投入した電力の半分が熱となる。この熱により、レーザ出力、効率、素子寿命は大きな影響を受ける。このような熱を効率良く冷却するため、熱伝導率が高く、熱容量が大きい水を冷媒とするヒートシンクが用いられる。このようなヒートシンクとしては、例えば、複数の銅製の平板状部材を組み合せて微細な流路を形成し、この流路内に冷却水を循環させる構成を有するヒートシンクが知られている。冷却水は、流路の上部に載置された半導体レーザアレイと熱交換して半導体レーザアレイを冷却する（例えば特許文献1および2参照）。

【0004】

このような装置は、半導体レーザアレイが複数積層されたスタック構造を有する。高出力化を図る場合には、複数のヒートシンクが、積層された各半導体レーザアレイの間にそれぞれ挿入されるようにして配置される。この場合、各ヒートシンクは各半導体レーザアレイの冷却を行うだけでなく、各々の半導体レーザアレイの間で電気的導通路の役割も果すため、各半導体レーザアレイの作動中にはヒートシンクにも電界が印加される（例えば特許文献1の図1参照）。

【特許文献1】国際公開第00/11717号パンフレット

【特許文献2】特開平10-209531号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、従来の水を冷媒とするヒートシンクを備えた半導体レーザ装置では、以下に示す流路の腐食を充分に防止することができず、長期にわたり冷却すべき半導体レーザアレイを効率良くかつ安定して冷却することができないという問題があった。

【0006】

すなわち、上記のような半導体レーザスタック装置においては、ヒートシンクは電気回路の一部を構成し、ヒートシンク自体にも電流を流すことから、ヒートシンク内部を流れ水に電流が流れる。冷却水には導電率を抑制したイオン交換水が用いられるが、イオン交換水も $1\text{ M}\Omega$ 程度の抵抗値を有するため、1V程度の印加電圧により $1\mu\text{A}$ 程度の電流が流れ、流路内でヒートシンクを電極として水の電気分解が発生してしまう。そうすると流路の内壁に電気化学的に腐食が発生する。このような腐食が進行すると、流路の目詰まり、水漏れ、漏電によるショート等の問題が発生する。

【0007】

本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、ヒートシンクの冷媒流路の腐食を防ぎ、長期にわたり半導体レーザアレイを安定して冷却することのできる半導体レーザ装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明は、半導体レーザアレイと、半導体レーザアレイに取り付けられたヒートシンクと、ヒートシンク内を流通する冷媒と、冷媒を前記ヒートシンクに供給する冷媒供給手段と、ヒートシンクと冷媒供給手段との間に接続され、冷媒が流通する絶縁性配管とを備え

、冷媒はフルオロカーボンを含み、絶縁性配管は内部に導電体が配置され、導電体は接地されていることを特徴とする。

【0009】

上記の構成によれば、冷媒として、水よりもはるかに反応性や導電性が低いフルオロカーボン (fluoro carbon) を用いたことにより、冷媒流路の腐食を防止することができる。さらに、絶縁性配管内に導電体が配置され、この導電体が接地されていることにより、絶縁性配管内をフルオロカーボンが流通した場合に生じる静電気を放電することができる。

【0010】

この場合、導電体は、絶縁性配管内の流路断面を覆うメッシュ構造を有するものであることが好ましい。

上記の構成によれば、絶縁性配管内を流れる冷媒との接触面積が広いため、帯電した静電気を放電する効果が大きいものとなる。

【0011】

この場合、導電体は、冷媒の流線に平行な断面が流線形の部分を含んでいることが好ましい。

上記の構成によれば、導電体の冷媒に対する抵抗が少なくなるため、絶縁性配管内を流れる冷媒の流速の変化を防ぐことができる。また、導電体の後流で渦が生じ、微小気泡核が生じることも防ぐことができる。その結果、キャビテーションの発生をより効果的に防ぐことができる。

【0012】

この場合、絶縁性配管は局所的に内径が拡大した拡径部を含み、拡径部に導電体が配置されていることが好ましい。

上記の構成によれば、冷媒の流速が高くなる導電体が配置された箇所の流速を、配管の内径を広げることにより抑えられるので、キャビテーションの発生をさらに効果的に防ぐことができる。

【0013】

この場合、平板状の半導体レーザアレイと平板状のヒートシンクとが、交互に複数積層されたものとすることができます。

本発明は、安定して半導体レーザアレイを冷却することができるため、このような半導体レーザスタック装置に適用した場合により効果を發揮するものである。

【発明の効果】

【0014】

本発明の半導体レーザ装置によれば、ヒートシンクの冷媒流路の腐食を防止しつつ半導体レーザアレイを長期にわたり安定して冷却し、安定したレーザ出力を得ることができる。さらに、フルオロカーボンが絶縁性配管内を通過したときに生じる静電気を放電して、静電気による静電気スパーク等を防ぐことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
図1は、本発明の第1実施形態に係る半導体レーザ装置の構成図である。図1に示すように、この半導体レーザ装置1は、半導体レーザスタック200と、チラー(冷媒供給手段)20と、これらを接続する絶縁性配管50と、これらの中を流通する冷媒40とから成る。

【0016】

チラー20は、空冷ユニット21と循環ポンプ22を備える。空冷ユニット21は冷媒40を冷却し、循環ポンプ22は絶縁性配管50を介して冷媒40を半導体レーザスタック200に供給する。

【0017】

冷媒40はフルオロカーボンから成る。フルオロカーボンは、炭化水素の水素原子の一
出証特2005-3036159

部あるいは全部をフッ素原子で置換した化合物である。フッ素原子の原子半径は水素原子のそれに比べて大きいため、フッ素原子は炭素の原子骨格を被覆する形となる。またフッ素原子は電気陰性度が大きく、電子雲はフッ素原子側に局在する。このため炭素骨格部の電子濃度が低下し、反応性は大幅に低下する。その結果、フルオロカーボンはほとんどの物質と反応しない高い化学的安定性を有する。また、フルオロカーボンは、 $10^{13} \Omega \cdot m$ という、水の $10^7 \Omega \cdot m$ に比べてはるかに高い抵抗率を有するので、水と異なり通電による電気分解を起こしにくい。さらに好ましくは、冷媒は、炭化水素の水素原子の全部をフッ素原子で置換した化合物であるパーフルオロカーボン (per fluoro carbon) である。パーフルオロカーボンは、特に化学的安定性が高く、抵抗率も高いため、冷媒として特に好ましい。

[0018]

絶縁性配管 50 は可撓性を有する絶縁性のパイプである。材質は、ナイロン系樹脂、ポリオルフィン系樹脂等等から成る。絶縁性配管 50 には、冷媒 40 の流量を調整するための流量調整弁 30 が設けられている。絶縁性配管 50 は、配管内部に導電体 52 が配置されている。導電体 52 は絶縁性配管 50 の流路断面を覆うメッシュ構造を有する。このメッシュ状の導電体 52 は、接地線 54 と接続され接地されている。

[0019]

0を自由に選
100301

【0020】 図7は、本実施形態に係る半導体レーザスタックを示す構成図である。半導体レーザスタック200は、3つの半導体レーザユニット100a～100c、プラス電極11、マイナス電極12、止めネジ14、供給口16、排出口18を備えて構成される。半導体レーザユニット100a～100cは、それぞれ半導体レーザアレイ2a～2c、n型電極6a～6c、シーリング用シリコンラバー8a～8c、ヒートシンク10a～10cを有する。半導体レーザアレイ2aはヒートシンク10aの上面とヒートシンク10bの下面との間に配置され、半導体レーザアレイ2bはヒートシンク10bの上面とヒートシンク10cの下面との間に配置され、半導体レーザアレイ2cはヒートシンク10cの上面に載置されることにより、半導体レーザアレイとヒートシンクは交互に積層配置されている。これらは止めネジ14により積層されたまま固定される。

100211

各ヒートシンク10a～10cは導電性であり、プラス電極11、ヒートシンク10a、半導体レーザアレイ2a、n型電極6a、ヒートシンク10b、半導体レーザアレイ2b、n型電極6b、ヒートシンク10c、半導体レーザアレイ2c、n型電極6c、およびマイナス電極12が順次、電気的に接続されている。これにより、プラス電極11とマイナス電極12との間に電圧を印加することで、半導体レーザアレイ2a～2cからレーザ光を出力させることができる。

[0022]

半導体レーザアレイ2a～2cは、一次元的に配列された複数の半導体レーザ素子を含んでおり、したがって、一列に並んだ複数のレーザ発光スポットを有する。本実施形態では、複数の半導体レーザ素子がモノリシックに集積された半導体レーザアレイを使用する。このような半導体レーザアレイでは、通常、活性層や電極を複数のストライプに分割して並列に配置することにより、複数のストライプ導波路が設けられている。なお、本発明では、このような構造の半導体レーザアレイに代えて、独立した複数の半導体レーザチップを一列に並べた構造の半導体レーザアレイを使用することもできる。

【0023】

供給口16、排出口18のそれぞれは、半導体レーザユニット100a～100cを貫通して設けられている。供給口16は半導体レーザユニット100a～100cの各々供給口と接続されており、排出口18は半導体レーザユニット100a～100cの各々の排出口と接続されている。シーリング用シリコンラバー8a, 8b, 8cは、その上の載置されるヒートシンク間の絶縁を確保するとともに、冷媒の漏洩を防止する役割を果たす。供給口16および排出口18は、前述の図1に示すような絶縁性配管50と接続され、冷媒40を供給される。

【0024】

ヒートシンク10a～10cは、噴流冷却型ヒートシンクであり、半導体レーザアレイ2a～2cの直下に設けられた小孔から冷媒を噴出させ、その冷媒の噴流乱流により、熱交換を効率的に行う型式のヒートシンクである。また、ヒートシンクをマイクロチャネル型のヒートシンクとし、微細な冷媒流路に冷媒を流通させ半導体レーザアレイの直下を冷却する型式のものとすることもできる。

【0025】

次に、本実施形態の半導体レーザ装置の機能について説明する。
本発明の半導体レーザ装置では、冷媒として従来用いられていた水に替えてフルオロカーボンを用いる。図8は、微細流路を流れる水およびフルオロカーボンについて流速と熱抵抗の関係を示すグラフ図である。横軸は流速を示し、縦軸は熱抵抗を示す。従来から、抵抗の関係を示すグラフ図である。横軸は流速を示し、縦軸は熱抵抗を示す。従来から、フルオロカーボンは水に比べて熱伝達特性がかなり劣ることが知られており、半導体レーザアレイの冷媒としては用いられていなかった。図8のグラフの実線および破線は、フルオロカーボンと水について流速と熱抵抗との関係を計算により求めたものである。この計算値に示すように、フルオロカーボンの熱抵抗（実線）は、各流速域で水の熱抵抗（破線）に比べてかなり大きく、冷媒として劣ることを示しており、従来からの認識を裏付けていく。

【0026】

ところが、本発明者らが、実際にフルオロカーボンと水を半導体レーザ装置のヒートシンクの冷媒として用いた場合を想定して実験を行ったところ、フルオロカーボンの熱伝達特性は予想よりも優れたものとなることが判明した。図8の菱形印および丸印は、半導体特性を想定した幅1mmの微細な流路にフルオロカーボンと水を各々流通させ、その流速に対する熱抵抗の測定値をプロットしたものである。図8の実測値に示すように、実際のフルオロカーボンの熱抵抗は計算値よりもかなり小さく、計算値（実線）では、フルオロカーボンの熱抵抗は水のそれに比べて、各流速域で1°C/W以上も大きいのに対し、実測値（菱形印）では0.5°C/W程度しか大きくなないこと/が判る。なお、水は計算値（破線）および実測値（丸印）ともよく一致していることが判る。

【0027】

このようにフルオロカーボンの熱伝達特性が計算値よりも、半導体レーザ装置を想定した実測値で優れたものとなる理由は、以下のようなものであると推測される。すなわち、フルオロカーボンは水よりも表面張力が小さい。そのため、半導体レーザ装置のような微細な冷媒流路にフルオロカーボンを流通させると、冷媒流路により微細なところまで進入することができるため、熱伝導の効果が推定したよりも大きくなる。その結果として、計算値よりも熱抵抗値が小さくなると考えられる。

【0028】

以上より、フルオロカーボンを半導体レーザ装置のヒートシンク用冷媒として用いた場合は、水に近い冷却効率を得ることができることが判明した。そして、フルオロカーボンは水に比べてはるかに化学的安定性が高く、導電性が低いため、冷媒流路の腐食を防止する効果も高いものとなる。

【0029】

その一方で、フルオロカーボンを冷媒として用いると、静電気が生じやすいという問題がある。半導体レーザ装置では、チラーと半導体レーザスタックとの接続は、一般的に可撓性を有する絶縁性配管が用いられる。可撓性を有する配管を用いることで、配管設置の便宜や、ロボット等の移動体に半導体レーザスタックを搭載する際の便宜を図ることがでできる。そして、高価な金属製のフレキシブルチューブに比べて、絶縁性配管ははるかに安い。そして、絶縁性配管は、金属製配管に比べて耐食性に優れる値であるという特徴を有する。また、絶縁性配管は、金属製配管に比べて耐食性に優れるという特徴も有する。

【0030】

しかし、 $10^{13} \Omega \cdot m$ という、水の $10^7 \Omega \cdot m$ に比べてはるかに高い抵抗率を有するフルオロカーボンをこのような絶縁性配管に流通させると、水を冷媒に用いた場合に比べて静電気が帯電しやすくなる。すなわち、絶縁流体であるフルオロカーボンの流れの摩擦に伴って、静電気が帯電し増加してくる。やがて、帯電した静電気の電圧が高電圧に達すると、隣接物体との間で静電気スパークが発生する。このスパークノイズが装置の誤動作等の原因となる。また最悪の場合絶縁破壊を起こし、配管が破断して冷媒が漏洩する。そこで上記第1実施形態では、絶縁性配管の内部にメッシュ状の導電体を配置し、さらに導電体を接地してある。これにより、帯電した静電気を放電することができる。

【0031】

以上のような図1に示す半導体レーザ装置1が動作する場合は、チラー20により冷却されたフルオロカーボンを含む冷媒40が、絶縁性配管50を介して半導体レーザスタック200に供給される。冷媒40は、ヒートシンク10a～10cに供給される。ヒートシンク10a～10cに供給された冷媒40は、ヒートシンク10a～10c上に配置された半導体レーザアレイ2a～2cを冷却する。ヒートシンク10a～10cから排出された冷媒40は、絶縁性配管50を介してチラー20に戻され、再び冷却されて半導体レーザスタック200のヒートシンク10a～10cを冷却する。

【0032】

ヒートシンク10a～10cを流通するフルオロカーボンからなる冷媒40は、冷媒流路を腐食することができないため、長期間にわたり安定して半導体レーザアレイ2a～2cを冷却することができ、素子寿命の向上、光出力の安定に寄与するものとなる。また、導電性の低いフルオロカーボンからなる冷媒40が、絶縁性配管50内を流通することにより生じる静電気は、導電体52から接地線54を介して放電され、静電気スパークの発生等を防止することができる。

【0033】

一方、フルオロカーボンを冷媒として用いた場合、水を用いた場合に比べてキャビテーションが生じやすいことが判明した。キャビテーションは、流体の流れで局部的に低い圧力を生ずる部分で流体の蒸発、溶解ガスの分離などが起こり、流体中に空洞を生じる現象である。キャビテーションが発生すると、発熱体との接触面積が減るため、熱交換効率が低下してしまう。

【0034】

図9は、水およびフルオロカーボンについて流速とキャビテーション数との関係を示すグラフ図である。図9から判るように、水(破線)に比べてフルオロカーボン(実線)は、各流速域でキャビテーション数が小さくキャビテーションが生じやすいことが判る。キャビテーション数が5以下になるとキャビテーション発生のリスクが大きくなる。

【0035】

図10は、上記の関係をまとめ、水およびフルオロカーボンについて流速と熱抵抗、並出証特2005-3036159

びに流速とキャビテーション数との関係を示すグラフ図である。図10の熱抵抗一流速曲線TFは、図8で示した水とフルオロカーボンの流速に対する熱抵抗の関係を示し、破線が水を、実線がフルオロカーボンを示す。また図10のキャビテーション数一流速曲線CFは、図9で示した水とフルオロカーボンの流速に対するキャビテーション数の関係を示し、破線が水を、実線がフルオロカーボンを示す。これより、流速に対し、熱抵抗とキャビテーション発生リスクは、トレードオフ（二律背反）の関係にあることが判る。キャビテーションが発生すると熱交換効率の低下、また壊食（機械的腐食）といった大きな悪影響が生ずる。従って、流速を抑えつつ、熱効率を高める必要がある。

[0036]

{0037}

この場合、例えばチラーの冷媒供給圧力を調整することで冷媒全体の流速を抑えること、熱抵抗が大きくなり、冷却効率が低下する場合がある。そのため、導電体の配置部分について、局所的に冷媒流速の高速化を抑える必要がある。

[0038]

図2は、第2実施形態に係る半導体レーザ装置の構成図である。この第2実施形態の半導体レーザ装置1'が第1実施形態と異なる点は、絶縁性配管50は局所的に内径が拡大した拡径部56を含み、拡径部56に導電体52が配置されていることである。

[0039]

図6は、第2実施形態に係る絶縁性配管内を流通する冷媒の位置と流速との関係を示す。図6は、第2実施形態に係る絶縁性配管内を流通する冷媒の流速は、拡径部56における。図6に示すように、絶縁性配管50内を流通する冷媒の流速は、拡径部56に入ると、流入すると緩やかに減少する。そして導電体52と接地線54が設けられた箇所に入ると、流速は増加する。しかし、拡径部56で流速が減少しているため、導電体52が設けられた箇所での流速增加は少ない。そして、導電体52が設けられた箇所を通過すると、流速は箇所での流速増加は少ない。そして、冷媒が拡径部56から排出されると流速や緩やかに増加し、やがて、拡径部56に入る前の流速に戻る。このように拡径部56を設けることにより、冷媒の流速の変化が抑えられ、キャビテーションの発生を防ぐことができる。また、このような流速の変化が抑えられ、キャビテーションの発生を防ぐことができる。また、このように配管の一部分のみを拡径することにより、配管の全部分を太くする必要がなく、水に比べて比較的高価なフルオロカーボンの量を少なくし、低コスト化を図ることができる。なお、この場合、絶縁性配管内の導電体が配置された箇所の流路断面積（冷媒通過断面積）と、導電体が配置されていない箇所の流路断面積とを等しいものとすることにより、流速の変動をより一層減少させることができる。

[0 0 4 0]

ところで、図3(b) (c)に示すようなメッシュ状の導電体に冷媒が通過すると、ヒートシンク部でのキャビテーション生成リスクが増大する可能性がある。

[0 0 4 1]

図4 (a) は第3実施形態に係るメッシュ構造を有する導電体を示す斜視図であり、図4 (b) はA-A' 線断面が流線形状の線材断面を有するメッシュ構造を示す図である。

図4 (a) に示すように、この導電体52'もメッシュ構造を有する。しかし、図4 (b) に示すように、導電体52'の絶縁性配管50の流線に平行な断面(図4 (a) のA-A'線断面)は、流線形状をなす。これにより、導電体52'の後流で渦が発生することを防ぐことができる。また、導電体52'の抵抗は少ないため、導電体52'を通過する冷媒の流速の変化は少なくなり、キャビテーションの発生を防止することができる。

【0042】

尚、本発明の半導体レーザ装置は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。

【図面の簡単な説明】

【0043】

【図1】第1実施形態に係る半導体レーザ装置の構成図である。

【図2】第2実施形態に係る半導体レーザ装置の構成図である。

【図3】(a)は第1実施形態に係るメッシュ構造を有する導電体を示す斜視図であり、(b)はA-A'線断面が円形の線材断面を有するメッシュ構造を示す図である。

、(c)はA-A'線断面が角形の線材断面を有するメッシュ構造を示す図である。

【図4】(a)は第3実施形態に係るメッシュ構造を有する導電体を示す斜視図であり、(b)はA-A'線断面が流線形状の線材断面を有するメッシュ構造を示す図である。

【図5】第1実施形態に係る絶縁性配管内を流通する冷媒の位置と流速との関係を示す図である。

【図6】第2実施形態に係る絶縁性配管内を流通する冷媒の位置と流速との関係を示す図である。

【図7】レーザスタックの構成図である。

【図8】微細流路を流れる水およびフルオロカーボンについて流速と熱抵抗の関係を示すグラフ図である。

【図9】水およびフルオロカーボンについて流速とキャビテーション数との関係を示すグラフ図である。

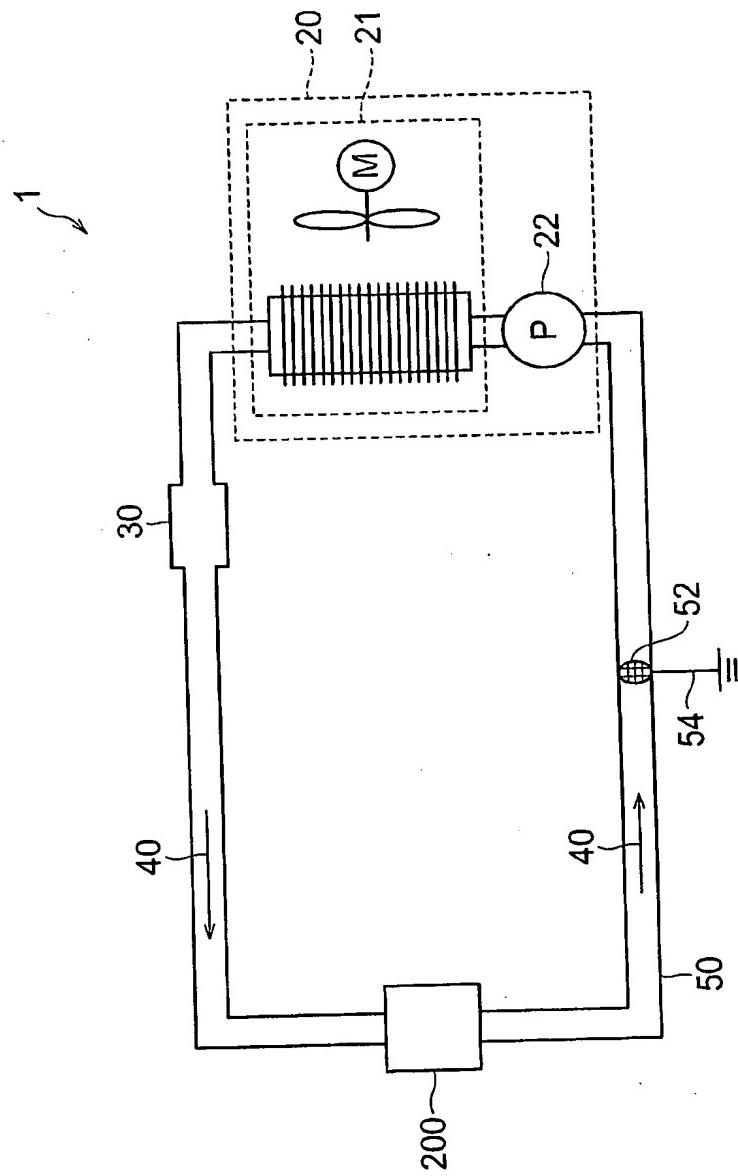
【図10】水およびフルオロカーボンについて流速と熱抵抗、並びに流速とキャビテーション数との関係を示すグラフ図である。

【符号の説明】

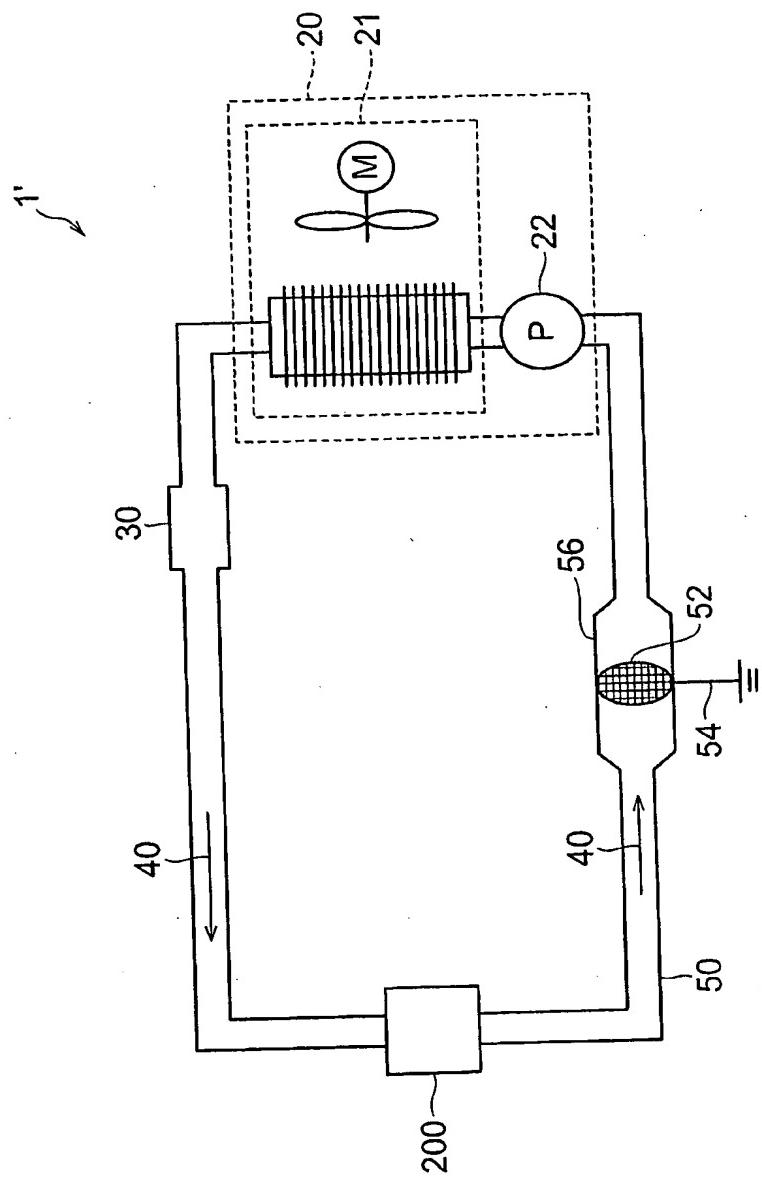
【0044】

1, 1'…半導体レーザ装置、2a, 2b, 2c…半導体レーザアレイ、10a, 10b, 10c…ヒートシンク、20…チラー(冷媒供給手段)、40…冷媒、50…絶縁性配管、52, 52'…導電体、54…接地線、56…拡径部、100a, 100b, 100c…半導体レーザユニット、200…半導体レーザスタック

【書類名】 図面
【図 1】



【図2】



【図 3】

52 ↗

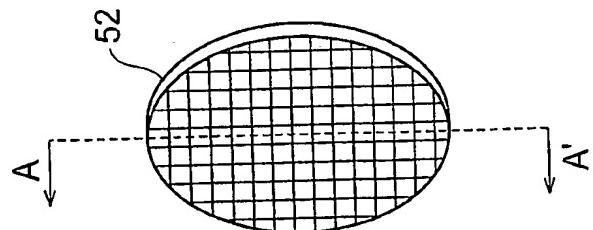


(c)

52 ↗

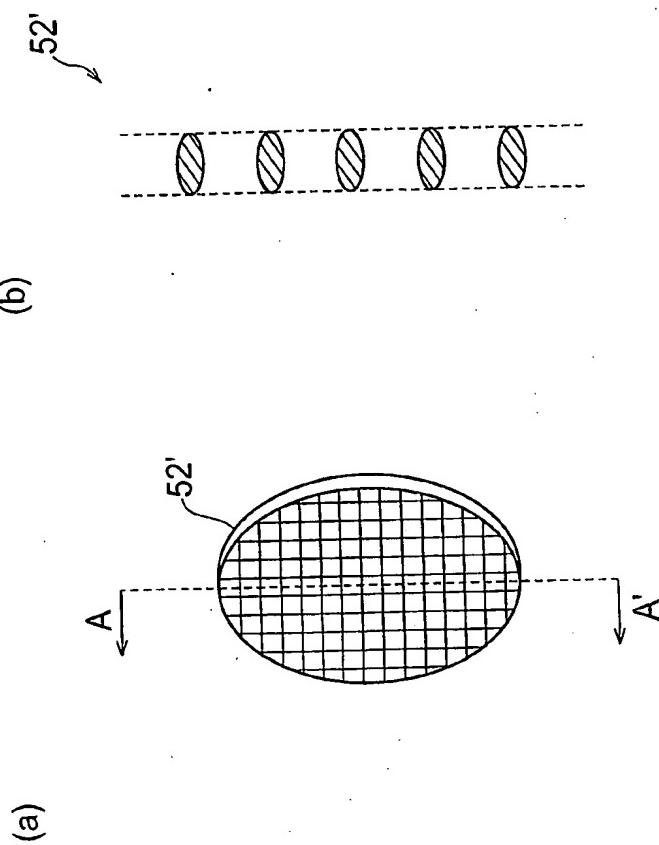


(b)

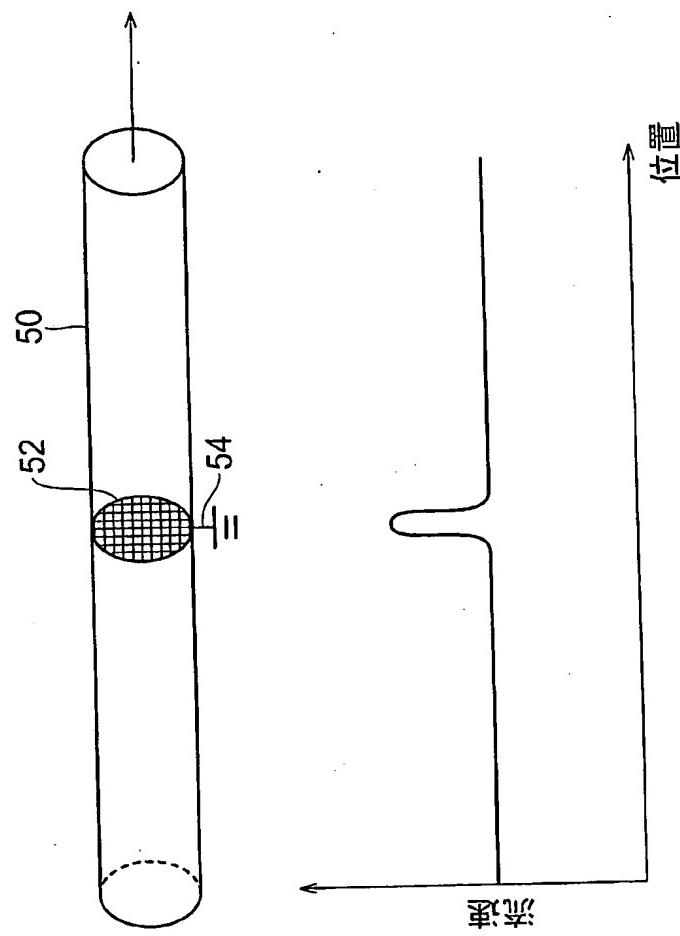


(a)

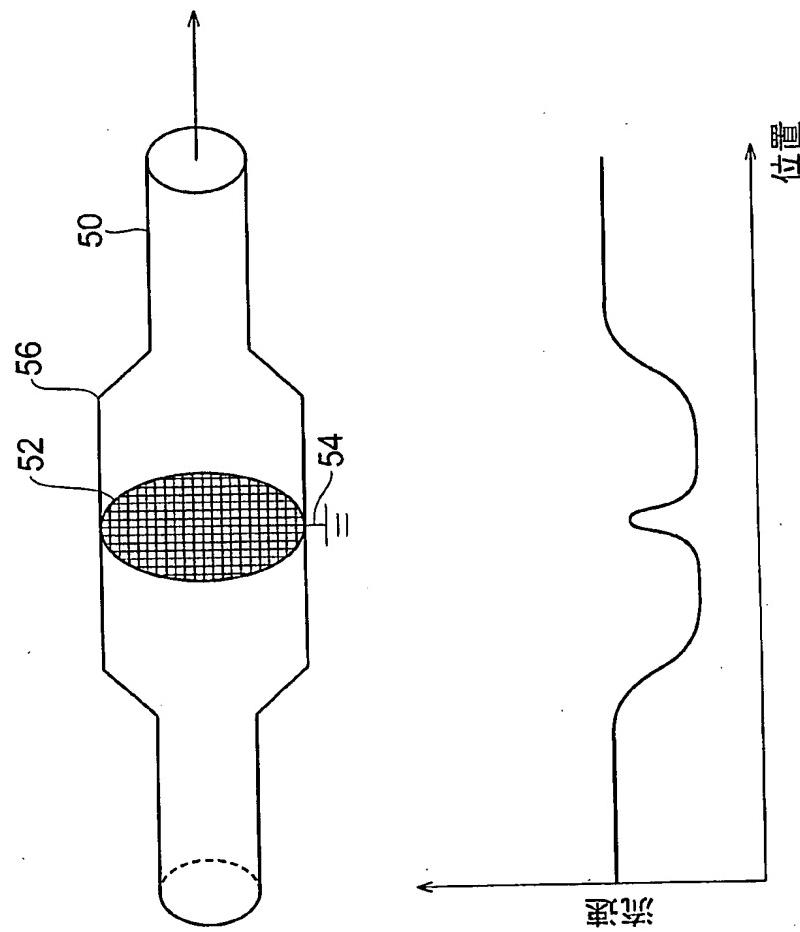
【図4】



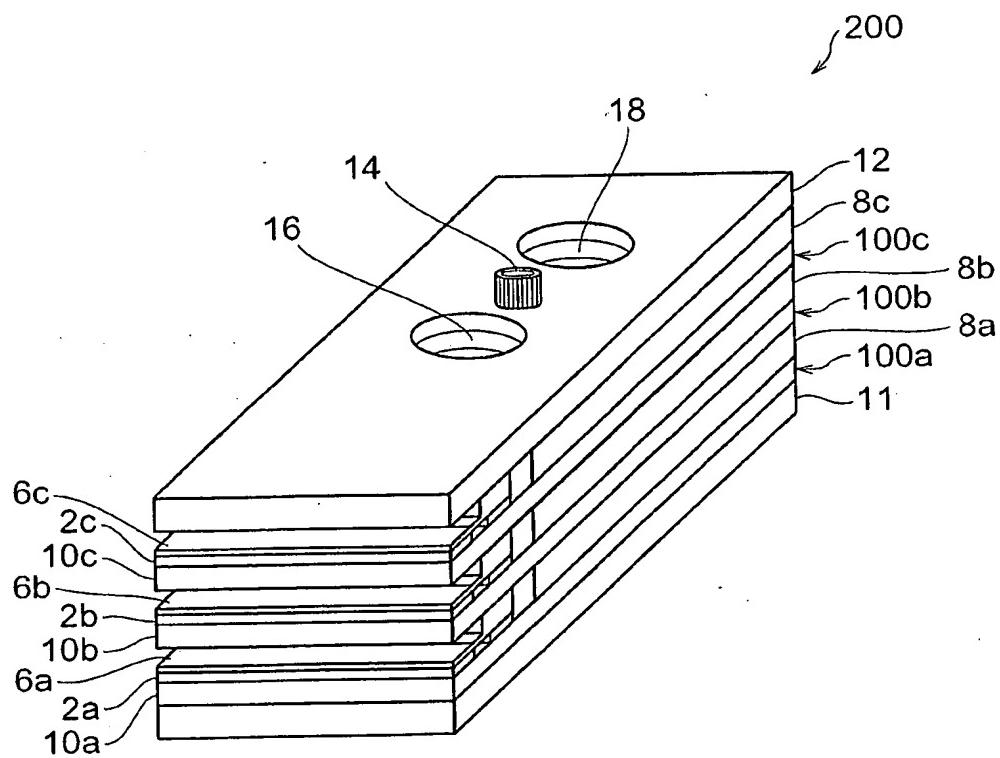
【図 5】



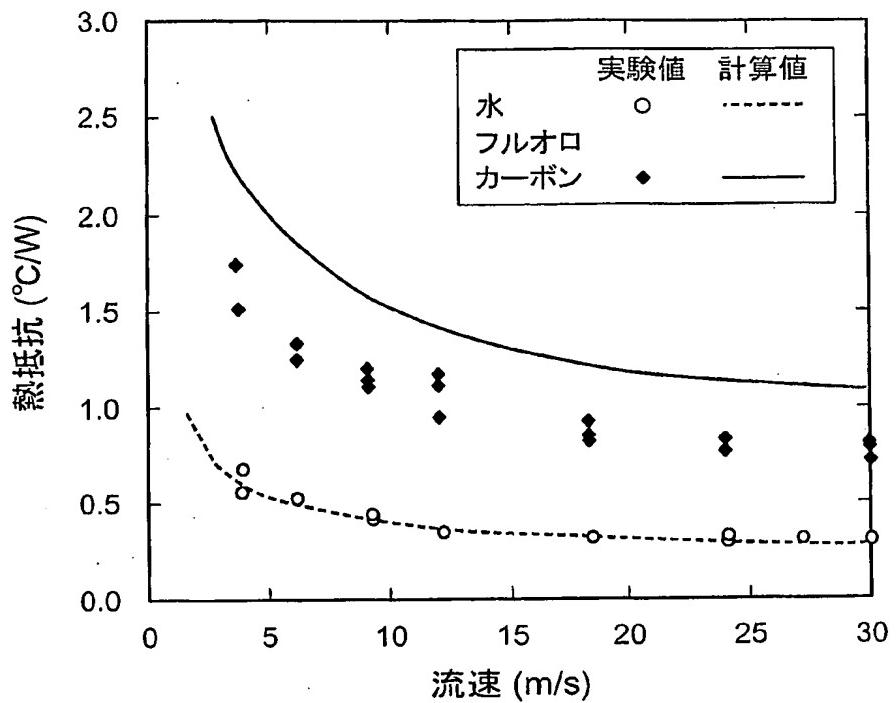
【図 6】



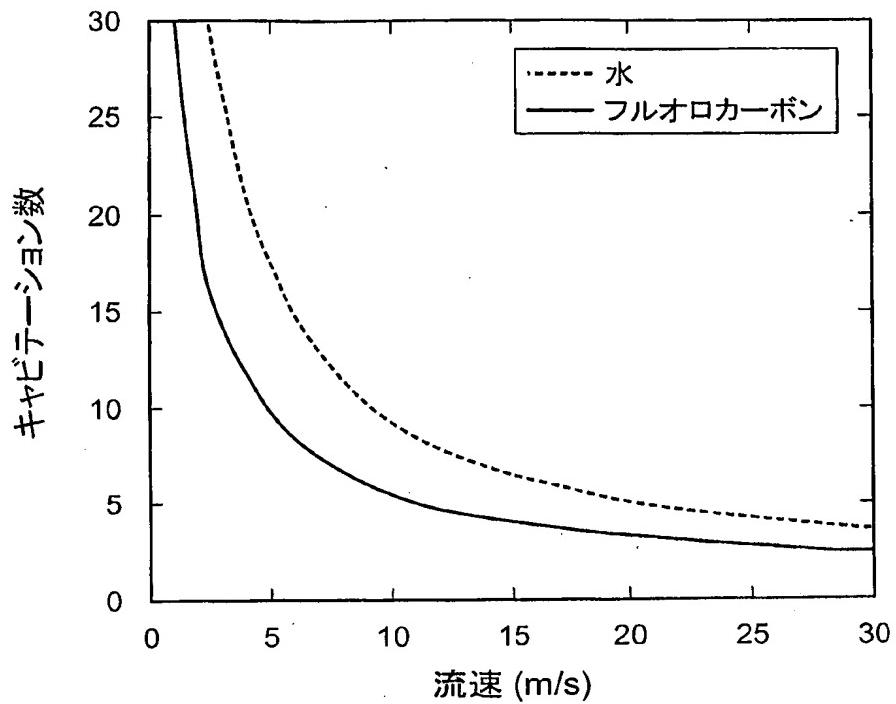
【図 7】



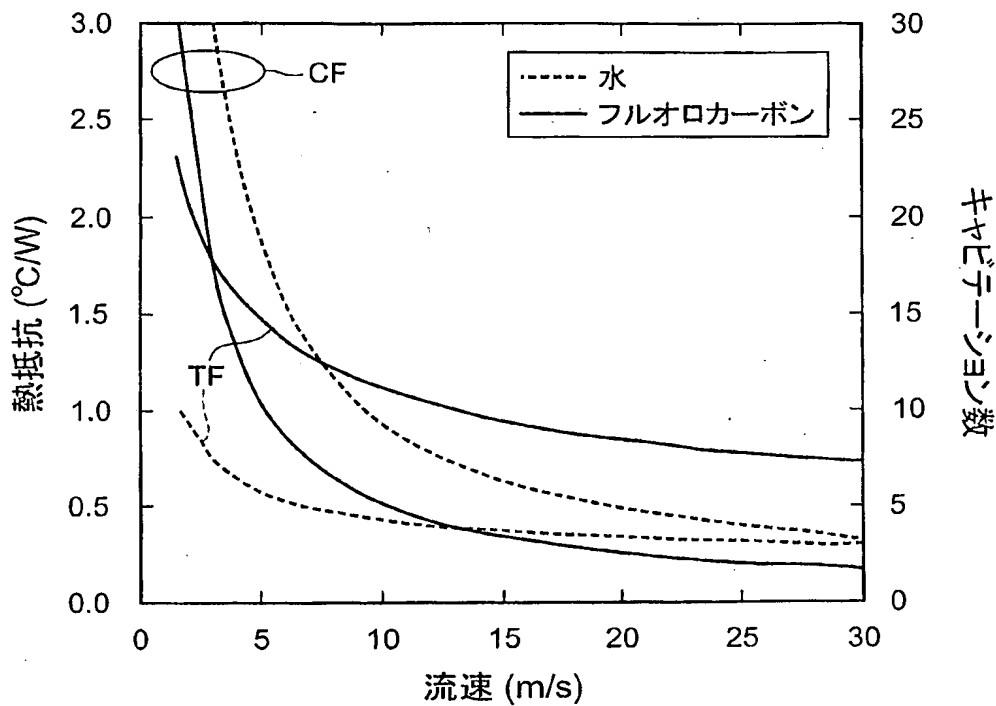
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 ヒートシンクの冷媒流路の腐食を防ぎ、長期にわたり半導体レーザアレイを安定して冷却することのできる半導体レーザ装置を提供する。

【解決手段】 半導体レーザ装置1は、半導体レーザスタック200とチラー20と絶縁性配管50と冷媒40とから成る。チラー20は冷媒40を半導体レーザスタック200に供給する。冷媒40はフルオロカーボンから成る。絶縁性配管50は可撓性を有する絶縁性のパイプである。絶縁性配管50は、配管内に導電体52が配置されている。導電体52は絶縁性配管50の流路断面を覆うメッシュ状である。メッシュ状の導電体52は接地線54と接続され接地されている。半導体レーザスタック200は半導体レーザユニット100a～100cを備える。半導体レーザユニット100a～100cは、それぞれ半導体レーザアレイ2a～2c、ヒートシンク10a～10cを有する。

【選択図】図1

特願 2004-076942

出願人履歴情報

識別番号 [000236436]

1. 変更年月日 1990年 8月10日

[変更理由] 新規登録

住 所 静岡県浜松市市野町1126番地の1
氏 名 浜松ホトニクス株式会社

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

**NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT**

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

Date of mailing (day/month/year) 01 July 2005 (01.07.2005)	To: HASEGAWA, Yoshiki SOEI PATENT AND LAW FIRM, Ginza First Bldg. 10-6, Ginza 1-chome Chuo-ku, Tokyo 1040061 JAPON
Applicant's or agent's file reference FP04-0488-00	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP2005/003979	International filing date (day/month/year) 08 March 2005 (08.03.2005)
International publication date (day/month/year)	Priority date (day/month/year) 17 March 2004 (17.03.2004)
Applicant HAMAMATSU PHOTONICS K.K. et al	

1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. *(If applicable)* The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
3. *(If applicable)* An asterisk (*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
17 March 2004 (17.03.2004)	2004-076942	JP	12 May 2005 (12.05.2005)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Authorized officer Remedios Landicho (Fax 338 7010) Facsimile No. (41-22) 338.70.10 Telephone No. +41 22 338 9999
---	--